

18/3 期上期受注 87.7%増の 213 億円、半導体製造装置受注は 5.9 倍の 80 億円に飛躍

株価 3140 円 (12/19) 時価総額 151 億円 (12/19) 発行済株 47,18 千株 (12/19)
 PER (18/3DO : 10.7X) PBR (1.37X) 配当 (18/3) 50 円 配当利回り : 1.59%

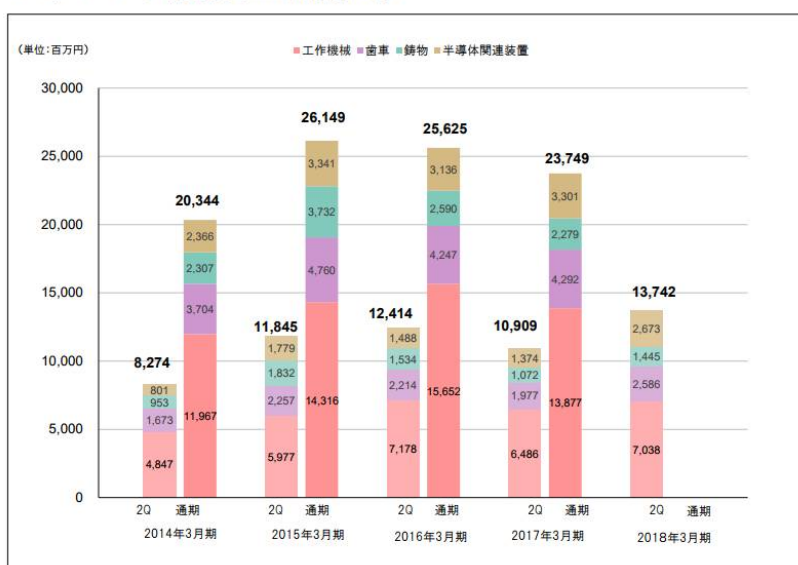
要約

- 18/3 期上期は半導体向け活況で 26%増収、営業利益 2.2 倍増、半導体製造装置倍増
- 18/3 期は 17.9%増収、40.4%営業増、75.7%経常増益も半導体関連装置活況で上振れへ
- 19/3 期中計目標の売上高 320 億円、営業利益 25.5 億円前倒し達成へ
- 株価は 18/3 期 DO 予想 EPS293 円に対し精密平均 PER26.3 倍の 7700 円目標

18/3 期上期は半導体向け活況で 26%増収、営業利益 2.2 倍増、半導体製造装置倍増

12/19 に 18/3 期上期決算説明会が開催された。開示内容で注目すべきはセグメント別売上高推移で、半導体製造装置は 94.5%増の 26.73 億円 (既に開示済み) で、その 80%は同社がシェア 70%を握る 300mm ウエハのファイナルポリシング装置が占めたとのこと。

セグメント別売上高推移



また新たに開示となった工作機械の部門別では研削盤などの工作機械が 9.5%増の 70.38 億円、新工場立上げとなった歯車が 30.5%増の 25.86 億円、鋳物が 34.8%増の 14.45 億円という内容。工作機械においては中小企業向けではなく 5000 万円以上の高単価となる超精密大型研削盤が工作機械メーカー



300mmウエーハ用全自動ファイナルポリッシャー

向けやリニアガイド製造企業向けなどに成約が相次ぎ、加えて半導体製造装置に多用され

るセラミックス部品加工向けにロータリー研削盤が伸長している。但し、受注急増に対し生産が追い付かない状況で、売上高の伸びは1ケタに止まった。現状、汎用研削盤は順調に出荷できるものの、大型機は半年程度の受注残、半導体製造装置向けなどでは1年の受注残を抱えている模様。歯車については産業用ロボット、自動車向けが伸長、新工場の立上げもあり、能増効果が出始めた。



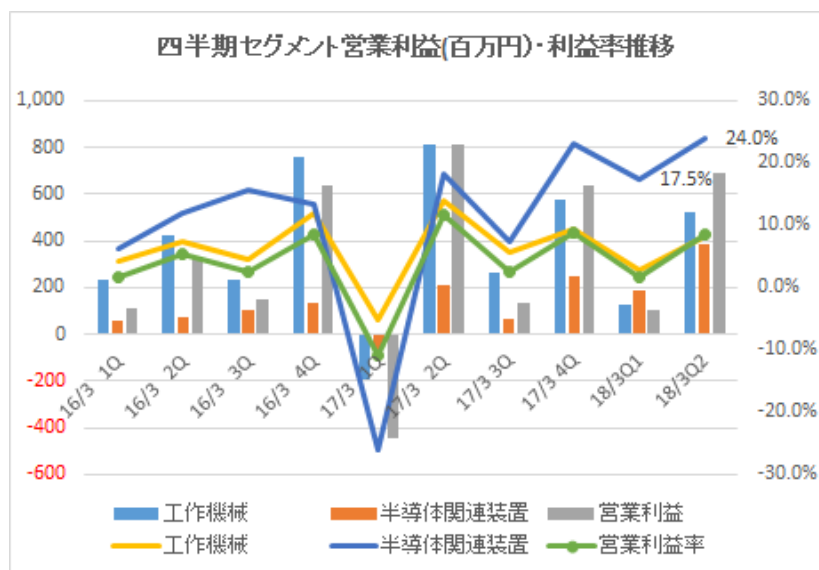
CNC精密平面研削盤



CNCロータリー超精密平面研削盤

18/3 期は 17.9%増収、40.4%営業増、75.7%経常増益も半導体関連装置活況で上振れへ

18/3 期会社予想の変更はなく、売上高 280 億円 (17.9%増)、営業利益 16 億円 (40.4%増)、経常利益 13.5 億円 (75.7%増)、税引利益 11 億円 (90.5%増)、配当 50 円予想。逆算で下期は売上高 142.58 億円 (前年同期比 11.0%増)、営業利益 8.03 億円 (同



3.9%増)。下期も工作機械、半導体製造装置とも受注に衰えを見せる要素がなく、協力工場などの活用も加え、受注増と受注残消化が進む中で、会社予想を上回る収益が期待される。

同社は特に半導体製造装置部門は生産能力上限が年間 65 億円程度と今期はかなりの受注残を積み増す形になるとみられる。工作機械は Q4 には上積み期待され、DO 予想の売上高 285 億円をクリアできると判断した。なお、決算説明会においては細かい情報について開示がなく、改めて取材の上で詳しい状況を報告する予定。

19/3 期中計目標の売上高 320 億円、営業利益 25.5 億円から上乘せ期待

現在、半導体においては微細化、3D 化、さらには 2019 年半ば完成を目指し大型 300mm ウエハ増産設備投資が控え、高付加価値のウエハーポリシャー、ポリシングマシン、グラインディングマシンの活況が続こう。また工作機械も研削盤は超精密大型研削盤が中国などでの大型 LCDTV 工場の新設ラッシュが加わり、米国向けに航空機向け需要も拡大しつつある。なお、LCDTV 設備投資に関連し、同社しか対応できない次世代 LCD フォトマスク用ポリシングマシンなどの受注も期待される。さら、先週まで開催されていたセミコンジヤパンにおいて、新たに半導体後工程向けに WLCSP (ウエハレベルチップサイズパッケージ) 研削における Cu+モールド樹脂加工で TSV (シリコン貫通電極) 研削の Cu+Si 等異種混合材同時平坦化製品をリリース、高効率で研削が可能となるファインバブル洗浄工程に特許があり、今後の展開が期待される。

上記の環境から、19/3 期収益は 19/3 期中計目標の売上高 320 億円、営業利益 25.5 億円を大きく凌駕してこよう。

株価は 18/3 期 DO 予想 EPS293 円に対し精密平均 PER26.3 倍の 7700 円目標

株価は 18/3 期会社予想 EPS249 円に対して倍水準と依然割安感がある。下期増額修正見通しで、DO 予想 EPS293 円に対して精密平均 PER26.3 倍の 7700 円を目標株価とする。なお今回の WLCSP 向け装置に加え、今後、次世代デバイス向け製造装置が量産具体化すれば、エッチングや CMP 工程を大幅削減し TSV ウエハ全自動薄化が可能となり、次世代半導体製造装置関連銘柄として 19/3 期 DO 予想 EPS497 円に対して PER30 倍の 15000 円まで大変貌する可能性がある。

岡本工作機械(6125)	(百万円、円)									
	売上高	増減率	営業利益	増減率	経常利益	増減率	税引利益	増減率	EPS	配当
16/3期	25,625	-2.0%	1,226	-14.3%	971	-6.2%	967	-7.0%	127.0	30.00
17/3Q1	4,027	-34.5%	-444	-503.6%	-541	-478.3%	-541	-478.3%	-129.6	0.00
17/3Q2	6,882	9.8%	810	144.0%	676	180.5%	709	194.2%	144.0	0.00
17/3Q3	5,607	-5.1%	135	-10.0%	77	79.1%	126	193.0%	21.6	0.00
17/3Q4	7,233	-1.0%	638	0.6%	556	2.2%	556	3.0%	94.4	40.00
17/3H1	10,909	-12.1%	366	-17.2%	135	-64.8%	168	-56.3%	14.4	0.00
17/3H2	12,840	-2.8%	773	-1.4%	633	7.8%	682	17.0%	116.0	40.00
17/3期	23,749	-7.3%	1,139	-7.1%	768	-20.9%	850	-12.1%	130.4	40.00
18/3Q1	5,675	40.9%	103	黒転	68	黒転	37	黒転	8.5	0.00
18/3Q2(8/9)会予	7,325	6.4%	397	-51.0%	282	-58.3%	213	-70.0%	48.0	20.00
18/3Q2	8,067	17.2%	694	-14.3%	627	-7.2%	477	-32.7%	107.7	20.00
18/3H1期初会予	13,000	19.2%	500	36.5%	350	158.8%	250	292.7%	56.5	20.00
18/3H1	13,742	26.0%	797	117.8%	695	414.8%	514	206.0%	116.2	20.00
18/3H2期初会予	15,000	16.8%	900	16.4%	1,000	58.0%	850	24.6%	192.1	20.00
18/3H2会予(11/13)	14,258	11.0%	803	3.9%	655	3.5%	586	-14.1%	132.4	30.00
18/3期初会予	28,000	17.9%	1,600	40.5%	1,350	75.8%	1,100	29.4%	248.6	50.00
18/3H2DO予	14,758	14.9%	1,203	55.6%	955	150.9%	786	15.2%	177.6	30.00
18/3期DO予	28,500	20.0%	2,000	75.6%	1,650	114.8%	1,300	52.9%	293.8	50.00
19/3期DO予(11/13)	36,000	26.3%	3,200	60.0%	2,900	75.8%	2,200	69.2%	497.2	80.00

半期	17/3H1	17/3H2	18/3H1	18/3H2D ○予	19/3H1D ○予	19/3H2D ○予
売上高	10,909	12,840	13,742	14,758	17,100	18,900
営業利益	366	773	797	1,203	1,500	1,700
経常利益	135	633	695	955	1,300	1,600
親株主帰属純利益	168	682	514	586	970	1,230
半期セグメント売上情報	17/3 2Q	17/3 4Q	18/3Q2	18/3Q4D ○予	19/3Q2D ○予	19/3Q4D ○予
工作機械	9,535	10,912	11,069	11,231	12,500	13,500
半導体関連装置	1,374	1,927	2,673	3,527	4,600	5,400
売上合計	10,909	12,840	13,742	14,758	17,100	18,900
半期セグメント営業利益	17/3 2Q	17/3 4Q	18/3Q2	18/3Q4D ○予	19/3Q2D ○予	19/3Q4D ○予
工作機械	623	842	650	950	1,000	1,100
半導体関連装置	146	311	573	727	1,050	1,200
合計	769	1,153	1,223	1,677	2,050	2,300
調整額	-403	-380	-426	-474	-550	-600
営業利益	366	773	797	1,203	1,500	1,700
	0	0	0	0	0	0
半期セグメント受注	17/3 2Q	17/3 4Q	18/3Q2	18/3Q4D ○予	19/3Q2D ○予	19/3Q4D ○予
工作機械	9,978	10,936	13,281	12,719	13,500	14,000
半導体関連装置	1,344	3,109	7,974	5,026	7,500	6,500
受注合計	11,247	14,120	21,255	17,745	21,000	20,500
利益率	17/3H1	17/3H2	18/3H1	18/3H2D ○予	19/3H1D ○予	19/3H2D ○予
売上高	131.8%	155.2%	166.1%	178.4%	206.7%	228.4%
営業利益	4.4%	9.3%	9.6%	14.5%	18.1%	20.5%
経常利益	1.6%	7.7%	8.4%	11.5%	15.7%	19.3%
親株主帰属純利益	2.0%	8.2%	6.2%	7.1%	11.7%	14.9%
半期セグメント営業利益率	17/3H1	17/3H2	18/3H1	18/3H2D ○予	19/3H1D ○予	19/3H2D ○予
工作機械	6.5%	7.7%	5.9%	8.5%	8.0%	8.1%
半導体製造装置	10.6%	16.1%	21.4%	20.6%	22.8%	22.2%
合計	7.0%	9.0%	8.9%	11.4%	12.0%	12.2%
調整額	-3.7%	-3.0%	-3.1%	-3.2%	-3.2%	-3.2%
営業利益	3.4%	6.0%	5.8%	8.2%	8.8%	9.0%

OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS,LTD.

2017/12/19

